

苏州国芯科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估 报告

为践行以“投资者为本”的发展理念，提高上市公司质量，树立良好市场形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，基于对公司未来增长潜力与内在价值所抱持的信心，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国芯科技”）于 2026 年 4 月 24 日披露了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“方案”）。2026 年上半年，公司依据该方案积极推进各项举措的落实，并严谨评估了方案的实施效果，公司于 2026 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》，现将半年度工作成果报告如下：

一、聚焦主营业务，确立“AI+量子安全”为核心发展路线

公司是一家聚焦于国产自主可控嵌入式 CPU 技术研发和产业化应用的芯片设计公司，致力于服务安全自主可控的国家战略，为国家重大需求和市场需求领域客户提供 IP 授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品，主要产品应用于汽车电子和工业控制、信创和信息安全、人工智能和先进计算三大关键领域。

2026 年上半年，公司持续聚焦主营业务，汽车电子、云安全、量子安全/量子密码芯片、人工智能业务实现进一步发展，特别是汽车电子芯片出货量显著增加，量子安全/抗量子密码芯片实现出货应用，边缘/端侧 AI 芯片应用加速落地。

2026 年上半年，公司明确提出“AI+量子安全”为未来新技术和新产品的主要发展路线。这一战略方向基于对公司现有基础和产业趋势的深度研判——一方面，AI 的爆发式增长带来海量数据处理需求，也对数据全生命周期安全提出了更高要求；另一方面，量子计算的快速演进对传统公钥密码体系构成系统性威胁，抗量子密码迁移已从学术研究走向产业落地。两条技术路线的交汇，正是公司差异化竞争优势的核心所在。在这一战略框架下，公司将“RISC-V CPU+NPU+HSM（硬件安全模组）”确立为 AI 芯片的技术底座，公司以 RISC-V CPU 为核心处

理器，内置 NPU 提供 AI 算力，集成 HSM（集成了抗量子和传统密码算法）实现硬件级数据加密保护。

（一）汽车电子芯片出货量显著增加，高端芯片应用与出货加快

公司汽车电子芯片业务坚持“MCU+”策略，即以 MCU 为核心，搭配混合信号（含驱动类）、通信接口芯片和传感器芯片，形成整体解决方案满足客户的“套片”方案式需求。这一策略有效提升了客户合作深度与黏性，使公司能够在与国外厂商的竞争中形成差异化优势。目前，公司已构建起覆盖“基础控制-高端智能”“MCU-数模混合-DSP”的较为完整的产品矩阵，12 条车规级芯片产品线逐步向高端演进，为解决我国汽车行业“缺芯”问题作出持续努力。

2026 年上半年，公司产品持续深化与比亚迪、奇瑞、吉利、上汽、上汽通用、上汽通用五菱、长安、长城、一汽、东风、北汽、广汽、小鹏、理想、蔚来、赛力斯等众多汽车整机厂商的合作，实现批量应用。

2026 年上半年，公司汽车电子芯片出货量超过 800 万颗，截至 2026 年 6 月 30 日累计汽车电子芯片出货量超过 3400 万颗；2026 年上半年实现汽车电子芯片业务收入 10,247.22 万元，同比增长 108.47%。2026 年上半年，包括 CCFC3007PT/BC、CCFC3008PT/PC、CCFC3010PT、CCFC3011PT、CCFC3012PT 和 CCD5001、CCD4001、CCD3001 在内的高端车规 MCU 和 DSP 芯片系列均已实现市场销售应用。公司中高端产品（安全气囊芯片、底盘芯片、域控芯片、DSP 芯片等）开始批量供货，收入实现较快增长。

在高端 MCU 方向，公司 CCRC4XXX 系列芯片（原 CCFC3009PT）是面向汽车辅助驾驶和跨域融合领域应用而设计开发的高端 MCU 芯片，基于 22nm RRAM 工艺，采用高性能 RISC-V 架构的多核 CRV6 CPU（最高实现 6 个主核+6 个锁步核），运行频率达到 500MHz，预计算力可达到 10000DMIPS 以上。芯片内置 NPU，支持未来 AI 功能拓展和可预测性维护，集成符合 NIST FIPS 203、FIPS 204 标准的抗量子密码算法，构建面向量子计算时代的车载安全防护体系。该芯片性能媲美英飞凌 TC49X 和瑞萨 U2B 系列芯片，且更具性价比优势，具备国际先进水平。2026 年上半年，该系列 CCRC4045S 与 CCRC4086S 两款产品均已内部测试成功并给客户送样开发，CCRC4045S 采用 6+6 核配置，对标英飞凌 TC48X/TC46X 和瑞萨 U2A16/U2B10；CCRC4086S 采用 8+4 核配置，对标英飞凌 TC4DX 和瑞萨 U2B24。

在车载声学 DSP 芯片领域，公司 CCD5001/CCD4001/CCD3001 系列采用 12nm 先进工艺技术和生产，已有多家客户在实际开发应用中，产品可广泛用于汽车音频放大器、音响主机、主动降噪 ANC/RNC、后座娱乐和数字驾驶舱等。2026 年上半年，车载音频 DSP 芯片实现出货 13.61 万颗，同比增长 860.16%。在 DSP 算法与生态合作层面，公司持续完善与国内外行业头部企业的合作生态，推动 DSP 芯片在车载音频领域的广泛应用。

在安全气囊芯片领域，公司安全气囊点火驱动芯片 CCL1600B 芯片已实现量产装车，并获得多个国际国内主流安全气囊 Tier1 厂商多项定点开发。作为国内首颗获得 TÜV 北德 ISO26262 ASIL-D 功能安全产品认证的安全气囊点火驱动芯片，已在多家整车厂实现装车应用和批量出货。公司 MCU 芯片在安全气囊控制器产品已实现稳定批量应用，出货持续增长。公司持续完善安全气囊控制器芯片套片方案，为客户提供整体解决方案。广汽集团与国芯科技联合开发的气囊点火芯片正在推进上车应用。公司与北京万得嘉瑞、浙江埃创、松原安全、安徽拙盾等积极推进安全气囊芯片的创新与应用。

在线控底盘领域，CCFC2012BC/CCFC2011BC 已经在客户的底盘类产品如换挡器、ABS、EPBI 等应用实现了批量供货和产品订单；CCFC2016BC/CCFC2017BC 用于空气悬挂系统和 CDC 悬挂转向控制，已进入实车测试阶段；CCFC3008PC 已经获得多家头部底盘线控转向控制器厂家定点开发，CCFC3007PT+CCL2200B 和 CCFC3010PT+CCL2200B 已经获得多家头部底盘线控制动控制器厂家定点开发。公司线控底盘芯片实现与国际头部 Tier1 的定点合作，产品在性能、可靠性和功能安全方面已得到更加广泛认可。

车规级安全 MCU 芯片作为公司汽车电子芯片的主力产品之一，2026 年上半年持续放量，出货超过 190 万颗，同比增长 80%。

在汽车电子混合信号芯片方向，公司集成化高压混合信号设计平台趋于成熟。公司面向 48V 汽车电池管理系统（BMS）熔断保护的高度集成系统级芯片 CCL1800BP 正在研发中。新一代汽车电子离手检测触控 MCU 产品 CCM4202S-O 已内部测试成功，该芯片基于 40nm EFLASH 工艺开发和生产，按照汽车电子 Grade2 等级、功能安全 ASIL-B 等级设计，具备高可靠性和高安全性，目前已有多家客户对该新产品开展了模组开发、应用测试及系统软件的开发。

（二）云安全和量子安全领航创新，自主可控生生不息

1、云安全芯片业务

公司在云安全领域深耕多年，已形成覆盖 CCP903T、CCP907T、CCP908T、CCP917T 等系列芯片，以及基于上述芯片设计的 PCI-E 密码卡、mini PCI-E 密码卡等模组产品的完整矩阵，技术实力和细分领域市场份额长期保持行业先进地位。公司云安全产品主要面向服务器、VPN 网关、防火墙、路由器、密码机、智能驾驶路侧设备、视频监控、电力隔离设备、可信计算和 5G 基站等领域，已规模化应用于海康、大华、信安世纪、安恒信息、格尔软件、国家电网、深信服、中安网脉、吉大正元、中星电子等合作伙伴的产品中。

2026 年上半年，基于公司新一代超高性能云安全芯片 CCP917T（已于 2025 年底通过商用密码检测认证，获得商用密码产品二级认证）研发的 PCI-E 密码卡产品 CCUPH2H01 和 CCUPH3H01 已在网络安全、云密码服务、可信计算等多个领域实现应用导入，其中 CCUPH2H01 已通过商用密码检测认证中心的商用密码检测认证，获得商用密码产品二级认证，并实现小批量出货。公司将云安全芯片 CCP917T 拓展应用于 AI 推理机、高性能可信安全服务器等云及边缘侧 AI 安全场景，并与中国人民大学苏州人工智能学院签约，共同研发 AI 安全推理一体机，面向电子政务、智慧工业、金融科技等领域。

2、量子安全芯片业务

公司量子安全芯片及模组产品采用量子随机数发生器技术对传统信息安全芯片及模组进行安全增强。公司量子安全芯片 A5Q 可以应用在智能终端、智能表计、加密摄像头和指纹 USBKey 等安全设备中。CCP907TQ 可以设计为量子 Mini PCI-E 密码卡和量子 PCI-E 密码卡等产品形态。目前，公司量子安全产品已成熟应用于电力、电信等关键领域。2026 年 6 月，中移互联网有限公司的量子安全服务平台 QKMS 与公司的量子密码卡 CCUPH2Q01 顺利完成兼容互认；此前，中移互联网的超级 SIM 密码服务平台与国芯科技的量子密码卡 CCUPH2Q01 以及抗量子密码卡 CCUPHPQ01 已分别完成兼容互认，标志着国芯科技量子安全、抗量子密码系列产品已可适用于运营商应用场景。

3、抗量子密码业务

量子计算的快速发展对传统公钥密码体系构成系统性挑战，抗量子密码迁移已成为全球密码产业确定性的技术演进方向。

公司与参股公司信大壹密合作研发的抗量子密码芯片 AHC001，基于国产

28nm 工艺完成投片并内测成功，该芯片支持传统密码与抗量子密码算法共存运行，适用于端侧及边缘侧高安全需求场景。目前，该款抗量子芯片产品正在国家重大需求领域客户进行验证应用。抗量子密码卡 CCUPHPQ01 可适配龙芯、飞腾、海光等主流平台，支持 UOS、麒麟、Linux 等主流操作系统，2026 年上半年已实现小批量出货。

公司联合中云信安合作研发的抗量子金融 POS 机芯片 CUni360SQ-ZX，截至 2026 年 6 月 30 日已累计出货超过 10 万颗，可广泛应用于智能 POS、Linux POS、电签 POS 等终端设备。基于公司累计超 1 亿颗的金融 POS 芯片出货基础，公司正在加快新一代抗量子金融 POS 产品的市场渗透。

同时，公司最新成功研发了汽车高性能域控芯片 CCRC4XXX 系列，是国内首款同时具备 AI 计算能力和抗量子安全能力的高端车规级芯片。

此外，围绕金融、能源、通信等关键领域应用，公司已与多家抗量子领域的产学研用单位展开深度合作，建立抗量子芯片技术和应用生态圈，主要包括南方电网、中科院信工所、复旦大学、西交利物浦大学、中移互联网、问天量子、信安世纪、北京 CA、得安信息、中云信安、信大壹密、泓格后量子、之江数安量子、国腾量子等。

（三）边缘/端侧 AI 芯片应用加速落地

截至 2026 年 6 月 30 日，公司端侧 AI 芯片 CCR4001S 在智能商用空调领域已累计实现超过 10 万颗出货，并在智能家电、智慧传感、电弧检测、电机控制等领域进行了 AI 芯片应用方案的开发，涵盖安全防护、智能家居、工业控制、电力等多元化场景。CCR4001S 采用 RISC-V 内核 CRV4H 设计，内置 AI 加速子系统（NPU 引擎），支持 TensorFlow/PyTorch/TensorFlow Lite/Caffe/ONNX 等深度学习框架，能够高效运行 MobileNet/ResNet/EfficientNet/Yolo 等深度学习算法。

公司坚持“RISC-V CPU+AI NPU”技术路线，在 NPU 领域形成系列化 NPU IP 核。面向 AI PC 应用的 CCRA8100(原 CCRA8001)GPNPU 芯片已完成设计，正在流片。

此外，公司正积极探索将汽车电子芯片领域积累的 RISC-V CPU、AI NPU、功能安全与信息安全等技术能力向具身智能与机器人领域迁移，相关工作处于方案探索阶段。

（四）芯片定制服务业务

公司积极开展为 AI ASIC 和高性能计算芯片等领域客户提供定制芯片设计及量产服务, AI ASIC 芯片定制服务是公司在 AI 领域的重要布局方向之一。2026 年上半年, 芯片定制服务业务收入为 15,914.36 万元, 同比增长 133.56%, 主要得益于定制 AI 芯片和高性能计算芯片服务业务增长较快, 在手订单充足。公司合同负债继续增长, 主要来源于该业务预收客户货款, 充足的合同负债为后续收入转化提供了明确支撑。

(五) 高强度研发投入, 新技术新产品持续突破

公司作为国内嵌入式 CPU 领域的核心供应商, 2026 年上半年继续发展边缘/端侧 AI 技术, 并将研究成果应用到现有的汽车电子和工业控制芯片产品以及信创和信息安全芯片产品, 持续投入 AI 神经网络处理器 NPU 技术的研发, 用“RISC-V CPU + AI NPU”的技术创新拥抱智能化浪潮; 另一方面, 公司积极布局 and 研发抗量子密码算法、芯片和模组产品, 持续推出具有国际先进水平的系列化量子安全和抗量子密码芯片与模组。

在嵌入式 CPU 领域, 公司继续基于 RISC-V 指令架构投入研发, 2026 年上半年与国际公司合作开发, 优化设计了适用于汽车电子高端域控支持虚拟化应用的 CRV6 CPU IP 核。公司已形成了 CRV0、CRV4、CRV5、CRV6、CRV7 和 CRV9 系列化 RISC-V CPU 内核系列, 可满足多方面市场应用需求。在 NPU 领域, 公司和香港应科院、龙擎空天等单位合作面向端/边缘侧应用和面向 AI PC 应用开展 AI 技术研发, 2026 年上半年重点开展了面向端/边缘侧 MCU 或 SoC 应用的 NPU IP 核 CNN200、CNN200-A 和 CNN210 以及面向 AI PC 应用的 GPNPU IP 核 CNN300 的研发。CNN200、CNN200-A 和 CNN300 已完成设计并可以对外授权; CNN210 正在研发中。CNN200/CNN200-A 采用 GCU+NN 网络架构设计, 其核心采用脉动阵列计算单元实现, 通过动态功耗与内存面积的协同优化, 结合数据零拷贝与混合精度计算, 有效降低能耗和延迟, 实现了业内先进的能效比。CNN210 是国芯自主研发的新一代 NPU IP 核, 面向端侧 Transformer LLM 推理与经典 CNN/RNN 推理的双重需求, 覆盖 IPC 智能安防、智慧医疗、智慧城市及 AI PC 等核心市场。CNN300 以标量运算单元和矢量运算矩阵相结合, 利用专用重构化可编程技术, 形成通用可编程形式的人工智能加速体, 单核性能可达 8TOPS@INT8, CNN300 具有多核一致性接口 MLS, 支持多个 CNN300 IP 核之间扩展实现更高算力, 保障单任务多核情况下数据流的同步和统一, 如利用四核

堆叠将实现 32TOPS@INT8 算力；MLS 接口也支持多颗集成 CNN300 IP 核的 SoC 芯片之间进行数据一致性同步，使得 SoC 芯片能够利用 Chiplet 机制实现多核多芯片算力堆叠效果。公司已形成面向端/边缘侧 MCU 或 SoC 应用的 NPU IP 核 CNN20、CNN100、CNN200、CNN200-A 和 CNN210 系列以及面向 AI PC 应用的 GPNPU IP 核 CNN300，可以满足多种类应用需求。

在云安全芯片技术方面，公司基于 RISC-V 架构多核 CPU 成功研发了超高性能云安全芯片 CCP917T，CCP917T 超高性能云安全芯片基于国芯科技自主 RISC-V 架构的 CRV7 多核处理器设计，CPU 主频可达 1.4GHz，其中 SM2 签名效率达到 100 万次/s，对称算法性能达到 80Gbps，集成了神经网络处理单元（NPU），可以适应更多高性能计算、高速数据处理和人工智能推理等复杂应用场景。报告期内，公司研发了 CCUPH2H50 密码卡和 CCUPH2H60 双芯片密码卡模组产品，基于 CCP917T 芯片形成了包括 CCUPH2H01（X16/X8）、CCUPH2H50、CCUPH2H60、CCUPH3H01 等系列化密码卡模组产品，实现系列密码卡基础 SDK 开发，国密标准 API 接口框架 SDF 开发；实现 CCP917T 系列密码卡对抗量子算法的支持；完成密码模块安全二级、安全三级资质的申请；实现 OpenSSL、DPDK、Linux Crypto Framework 等框架对 CCP917T 系列密码卡的支持；实现虚拟化场景下（KVM，Docker）的密码卡配套软件开发和应用支持；基于客户应用需求进行定制开发，支持客户完成 CCP917T 系列密码卡的适配，包括 SSL 网关、电力网关、加密机、云服务器密码机等。

针对 NIST 公布的基于格原理、哈希原理和编码原理三种类型的五个抗量子密码算法，已开展从抗量子密码算法理论研究、算法硬件架构设计、算法软硬件实现、算法侧信道安全等多层次多维度的深入研究。在完成了 NIST FIPS 203（ML-KEM）、FIPS 204（ML-DSA）、FIPS 205（SLH-DSA）三个算法模块的硬件设计的基础上，报告期内新完成了 FIPS 206（FN-DSA）和 HQC 二个算法模块的硬件设计，其中 ML-KEM、ML-DSA 和 FN-DSA 是基于格原理的抗量子密码算法，SLH-DSA 是基于哈希原理的抗量子密码算法，HQC 是基于编码原理的抗量子密码算法。除已经实现了 NIST 公布的五个抗量子密码算法之外，还完成了基于哈希原理的 XMSS 算法，基于多变量原理的 UOV 算法和基于同源原理的 SIKE 算法的硬件开发。同时，2026 年上半年，公司还提交了 12 个抗量子密码算法硬件设计及侧信道防护相关的专利申请，后续还将基于现有的格原理的抗

量子密码算法引擎添加更多的算子指令，从而能支持更多的基于格原理的抗量子密码算法，包括 Aigis、LAC 和 SCLLOUD+等主流格原理密码算法。在不断充实公司抗量子密码算法 IP 库的同时，对算法硬件模块的性能、面积和功耗进行深度优化，提升抗量子密码算法 IP 的竞争力。

在 AI 芯片技术方面，围绕 CCR4001S、CCR7002 两款端侧/边缘侧 AI 芯片，公司在 2025 年上半年积极开展应用方案的开发工作，CCR4001S 在智能家电、电弧检测等应用领域已推出了产品化方案，在智能商用空调领域已实现累计超过 10 万颗的量产出货。已完成研发、正在流片的 GPNPU 芯片 CCRA8100（原 CCRA8001）是一款高性能可应用于 AI PC 的人工智能加速 SoC 芯片。CCRA8100 基于先进工艺设计，搭载 64 位高性能四核 RISC-V 架构的 CRV7AI CPU，多核算力达 32TOPS@INT8，支持 INT4/INT8/FP16 等常规 AI 应用所需要的数据类型，支持传统的 CNN、RNN 应用，也能支持典型的 LLM（大语言模型）应用，可以配合应用进行 Deepseek、Qwen、LLaMa 等常用大模型卸载，满足常规诸如语音图像视频识别应用场景，也能够支持 AI PC 应用的高品质语音视频显示、生成式人工智能（如文生文、文生图等）、MoE（多模态交互）、知识库管理等应用。CCRA8100 支持多芯片互联机制，利用 UCIe 接口采用 Chiplet 方式将自身多颗芯片以矩阵互联、IO 互联的形式堆叠，实现多核应用和算力扩展。相比于传统 ASIC 形式算力芯片，CCRA8100 的 GPNPU 机制具有灵活可重构的特点，可以广泛、快速适用于未来 Deepseek 之外的新大语言模型应用场景。

二、注重知识产权保护，转化成果显著

公司积极鼓励员工进行技术创新和知识产权保护，在研发过程中及时将创新成果转化为知识产权。2026 年上半年，国芯科技申请专利 50 项（其中发明专利 50 项、实用新型 0 项、外观专利 0 项）、软件著作权 3 项、集成电路布图 6 项、商用密码证书 7 项；获得授权专利 18 项（其中发明专利 18 项、实用新型 0 项、外观专利 0 项）、软件著作权 3 项、集成电路布图 6 项、商用密码证书 7 项。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计获得有效发明专利 194 项，累计获得有效实用新型专利 5 项，累计获得有效外观设计专利 3 项，累计获得有效软件著作权 240 项，累计获得有效集成电路布图 53 项，累计获得有效商用密码证书 45 项。

作为一家关注自主可控的 CPU 设计公司，国芯科技始终将技术创新视为公司发展的生命线与核心驱动力，并将知识产权视为保护创新的关键基座。公司将

持续推动把员工的宝贵创新成果及时转化为知识产权，从而为公司的长远发展注入源源不断的动力。

三、加快市场推广，重视品牌建设

（一）市场推广与品牌传播

2026 年上半年，公司积极通过多种渠道展示技术实力与产品成果。公司先后参加了 2026 北京国际汽车展览会等行业知名展会，集中展示了汽车电子芯片等核心产品。同时，公司策划并完成了“走进主机厂”系列活动，与一线汽车工程师面对面交流，展示公司最新产品和解决方案。在媒体方面，公司与行业媒体保持积极交流，有效传递公司价值。

（二）客户拓展与战略合作

2026 年上半年，公司继续推行“MCU+”策略，通过套片方案深化与头部客户的合作黏性，推动中高端芯片在更多车型实现量产装车。在信创与信息安全领域，公司加快推进 RAID 卡全栈软硬件方案在国产服务器主机平台的适配工作，已完成海光、龙芯、飞腾、兆芯、申威等主流平台认证并支持麒麟、UOS 等国产操作系统；金融 POS 机芯片伴随国内终端头部企业出海，持续拓展全球市场。

（三）品牌影响力与行业荣誉

2026 年上半年，公司品牌公信力与行业地位持续提升。公司及子公司先后荣获证券时报社颁发的“第十七届中国上市公司投资者关系管理创新实践天马奖”、江苏省商用密码协会颁发的“2025 年度优秀密码应用方案奖-金融 POS 终端安全芯片产品应用解决方案”、北京市经济和信息化局颁发的北京市“创新型”中小企业、中国汽车芯片产业创新战略联盟颁发的“2026 年度影响力汽车芯片”、深圳市汽车电子行业协会颁发的“2025 年度汽车电子科学技术奖-创新产品奖”、AEPC 汽车电子专业委员会颁发的“2026 国产车规芯片新品 TOP30”以及中国集成电路设计创新联盟、AEPC 汽车电子专业委员会与《中国集成电路》杂志社联合颁发的“2026 金芯奖·创新企业奖”等奖项。同时，2026 年 4 月，公司获批建设“RISC-V 开源芯片先进技术研究院”。

（四）产业生态与前沿技术布局

2026 年上半年，公司立足江苏省 RISC-V 产业联盟理事长单位、开源 RISC-V 汽车电子芯片创新联盟和苏州 RISC-V 开源芯片产业创新中心牵头单位，以及苏州市 RISC-V 开源芯片先进技术研究院建设主体等生态角色，持续加大产业链协

同：积极组织 RISC-V 技术研讨会，推动 RISC-V CPU、NPU 及抗量子技术在汽车电子、安全芯片等关键领域渗透。同期，公司依托与问天量子、合肥硅臻分别共建的量子芯片联合实验室，持续推进量子安全芯片研发与量产供货；2026 年 2 月，全资子公司天津国芯与中国移动旗下芯昇科技签署战略合作协议，共同推进量子/抗量子及 RISC-V 技术在物联网与运营场景落地。在抗量子方向，公司上半年持续推进江苏省抗量子密码芯片技术重点实验室（筹）的申报与筹建工作，于 2026 年 7 月正式获批牵头联合西交利物浦大学共建。该平台的落地，将为公司既有的抗量子技术研发体系注入强劲动能，进一步巩固在核心赛道的长效竞争力。

四、强化内部管理，提升经营效能

2026 年上半年，公司持续完善科学、高效的管理体系，围绕提质增效与风险防控，运行基于数据驱动的“预测-执行-反馈-改进”管理机制，有效推动公司整体管理效能提升，为经营改善提供了有力支撑。

（一）现金流管理持续改善

2026 年上半年，公司持续加强现金流预算管理，深化月度现金流分析机制，对经营进展和现金流状况进行动态跟踪与研判，及时提出改善建议。公司运行财务风险预警系统，对经营性现金流、自由现金流等关键指标实施实时监控与预警，深化资金计划与业务计划的穿透式管理，强化预算编制、执行监控、差异分析的闭环管控。通过上述举措，2026 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 9,725.09 万元，较上年同期的 5,253.57 万元增长 85.11%，经营活动现金流净流入显著扩大，为公司各项业务开展提供了资金保障。

（二）存货管理持续深化

2026 年上半年，公司着力完善存货全链条管控机制。在计划端，强化销售订单与库存数据的联动匹配，提升排产精准度，减少无效备货。期末存货较期初有所增加，主要系在手订单增长及安全备货需求所致，整体处于合理可控水平。核算管理方面，严格执行会计准则要求，完善存货跌价测算模型，结合近期市场成交价格及产品迭代趋势审慎确定可变现净值，保障期末存货价值真实、准确。

（三）应收账款管理稳步推进

2026 年上半年，公司落实主要客户定期信用评估机制，结合市场情况对销售策略和付款条件进行动态管理；结合业务特性与客户合作情况，对结算及账期

安排进行动态优化；根据业务类型和客户特点，对价格策略做差异化调整。相关工作按节奏推进，新增账款风险控制在预期范围内。

（四）采购成本管控取得实效

2026 年上半年，公司主要围绕既有机制抓落实。严格执行采购审批流程，强化预算约束与计划管理，对请购、验收等各环节单据做好合规性审核，实时跟踪主要原材料的价格变动情况。定期开展供应商绩效评价，重点跟进质量、交期及售后表现，维持采购渠道基本稳定。结合市场行情与供应商保持常态化沟通，适时调整采购节奏与商务策略。采购成本总体保持平稳。

（五）运营流程持续优化

2026 年上半年，公司持续优化芯片设计开发、供应商管理及问题管理等核心流程。定制芯片业务供应链保持正常状态，交付能力稳定。公司持续加强与晶圆制造、封装测试等核心供应商的协同合作，保障产能稳定供应，进一步提升客户交付效率。

（六）质量管理体系深化建设

2026 年上半年，公司质量管理体系高效运行，围绕合规运营、供应链质量协同、客户端质量提升及产品可靠性验证四大维度持续深耕，顺利通过了 7 次客户审核，并完成 10 款产品的 AEC-Q100 认证，为市场拓展提供了坚实支撑。下半年，公司将进一步聚焦核心客户需求，全力保障重点产品的高质量交付；同步推进 IATF16949 体系认证工作，强化人才梯队建设，以满足汽车电子产线投产的严苛标准。在数字化与智能化应用方面，立足现有 IT 系统架构持续优化，推进 AI 辅助工具在工作中的试点应用；公司正结合实际业务需求，通过常态化反馈机制梳理相关工具的应用表现，并视适配成熟度逐步拓展使用范围。

（七）人才团队建设持续加强

2026 年上半年，公司关键和骨干人才保持相对稳定，为各项研发和市场开拓工作提供了有力保障。公司重视员工的培训与发展，在了解员工，尤其是新员工的培训需求、职业发展目标和技能差距的基础上，有针对性地设计了丰富的专题、专业技能培训，切实提升员工技术水平。同时，加强项目考核与激励机制，对项目贡献较大的员工进行及时激励，提升员工的主动性和积极性。公司以 2025 年限制性股票激励计划设定的 2026 年归属于上市公司股东净利润为正的考核目标为牵引，持续推动分解落实与过程管理，强化考核结果导向，确保激励方案有

效服务于公司经营改善目标。

五、压实“关键少数”责任，强化公司治理与风险管理

2026 年上半年，公司始终高度重视实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，持续强化其履职管理和责任体系建设。公司及时向董事、高级管理人员及关键岗位人员传达监管动态与政策解读，结合案例警示与法规宣导，持续提升“关键少数”的合规意识与履职能力。在机制建设方面，公司不断完善信息沟通与决策支持体系，为独立董事及各专门委员会有效履职提供必要保障；同时，持续优化高级管理人员短期与中长期相结合的激励约束机制，将绩效考评与公司战略目标、长期价值紧密衔接，推动“关键少数”勤勉尽责、主动作为，为公司高质量发展提供持续支撑，维护全体股东利益。

六、提高信息披露的质量，提升沟通效能

2026 年上半年，公司严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务。公司按期披露定期报告，临时公告信息披露工作符合监管各项要求。

2026 年上半年，公司持续完善投资者关系管理体系，荣获证券时报社颁发的“第十七届中国上市公司投资者关系管理创新实践天马奖”。报告期内，公司通过多渠道深化与资本市场的沟通：在上证路演中心召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会；积极参与券商策略会及机构调研，累计接待超 30 次投资机构及个人的现场及线上交流。同时，公司充分发挥“苏州国芯科技”公众号等新媒体矩阵作用，常态化通过邮箱、投资者专线及上证 e 互动平台与投资者保持密切互动，e 互动平台投资者提问回复率达 100%。公司始终致力于通过多种渠道，及时、准确、完整地传递业务模式、技术优势及研发进展等核心价值信息，切实保障全体投资者享有平等的知情权，不断深化市场对公司发展战略的理解与认同。

七、重视投资者回报，努力提升公司经营质量

2026 年上半年，公司持续重视投资者回报。公司正通过推动定制芯片业务的增长、中高端自主芯片规模化上量、持续降本增效等措施，努力改善综合盈利能力，全力推进全年扭亏为盈的目标。截至 2026 年 6 月末，公司合同负债达 11.43

亿元，较 2026 年 3 月末进一步提升，其中主要来源于云侧 AI ASIC 芯片和高性能计算芯片定制服务客户的预付款，充足的合同负债为后续收入转化提供了明确支撑。公司力争以更好的经营业绩回报广大投资者，实现公司价值与股东利益的共同增长。

公司将抢抓“十五五”开局的战略机遇期，以只争朝夕的干劲抢抓机遇，以钉钉子精神狠抓落实，切实推动公司高质量发展，为股东创造更大价值，努力成为我国领先的具有可持续发展能力的自主嵌入式 CPU 设计企业，从而更好地回报广大投资者。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日